

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2026 年 1 月 13 日-1 月 14 日)

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 专场机构交流会 <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观
参与单位名称及人员姓名	泰康资产 严志勇、泰康资产 王嘉艺、泰康资产 袁哲航、泰康资产 余思雨、3W Capital 雷鸣、广发证券 王亮、广发证券 张大伟、广发证券 耿正、乾图投资 黄立国、中金公司 温晗静、中金公司 江磊、Cloud alpha 杨茉然、青岛华燕亿澄 张子燕
会议时间	2026 年 1 月 13 日 10: 00-11: 00 2026 年 1 月 13 日 14: 30-15: 30 2026 年 1 月 14 日 15: 00-16: 00
会议地点	佰维存储三楼会议室
上市公司接待人员姓名	公司管理层 董办工作人员
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1. 公司 2025 年全年的业绩表现如何？如何展望 2026 年第一季度的业绩情况？</p> <p>A1: 从 2025 年第二季度开始，随着存储价格企稳回升，公司重点项目逐步交付，公司销售收入和毛利率逐步回升，经营业绩逐步改善。存储涨价属于行业利好，从历史经验来看，都会受益。展望 2026 年，伴随行业产品价格上涨的影响持续释放，以及公司面向 AI 新兴端侧领域的高价值产品持续批量交付，公司的营业收入和利润有望持续改善。</p> <p>Q2. 公司在 AI 眼镜市场具有优势地位，目前在各大客户的产品合作方面有什么进展？</p> <p>A2: 公司 ePOP 系列产品目前已被 Meta、Google、小米、阿里、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其 AI/AR 眼镜、智能手表等智能穿戴设备上，根据媒体公开信息，Meta 正在扩大其 AI 智能眼镜的产能，公司为 Meta AI 智能眼镜提供 ROM+RAM 存储器芯片，是国内的主力供应商。同时，公司持续拓展北美其他 AI 标杆客户，推进在 AI 新兴端侧领域的合作；在国内市场方面，公司积极与国内各大互联网厂商密切合作，共同拓展 AI 端侧产品应用。</p> <p>Q3. 公司如何看待当前存储行业的价格上涨及持续性？公司如何保障原材料供应？</p> <p>A3: NAND Flash 方面，TrendForce 集邦咨询预测产品价格将在 2026 年第一季度持续上涨 33-38%。DRAM 方面，TrendForce 集邦咨询预测一般型 DRAM 价格在 2026</p>

	<p>年第一季度继续上涨 55-60%。目前存储价格持续回升，叠加 AI 眼镜等新兴应用需求旺盛，从当前时点来看，景气度仍会持续。公司积极备货，目前库存较为充足。在原材料采购方面，公司与全球主要的存储晶圆厂商和晶圆代工厂合作进一步深化，与主要存储晶圆原厂继续签订 LTA（长期供应协议）。此外，公司北美客户亦积极与原厂沟通，帮助公司锁定原厂产能，有效保障关键原材料的稳定供应，为业务持续扩张提供了坚实基础。</p> <p>Q4. 公司晶圆级先进封测制造项目的最新进展如何？构建晶圆级先进封测能力的主要目的有哪些？</p> <p>A4：公司晶圆级先进封测制造项目整体进展顺利，目前正按照客户需求推进打样和验证工作，为客户提供“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案。公司通过晶圆级先进封测制造项目构建晶圆级封装能力，一方面可以满足先进存储封装需求，为公司研发和生产先进存储产品构建技术基础，提供相关封装产能；另一方面可以与公司存储业务协同，为相关客户提供存储解决方案+晶圆级先进封测服务。公司坚持“研发封测一体化”的战略布局，持续增加产业链覆盖环节，发挥公司在自研主控、先进封测、测试设备等领域的优势，提升产业链价值占比和产品附加值，不断提升公司行业竞争力和盈利稳定性。</p> <p>Q5. 公司关注到存储行业有哪些新的结构性机会？</p> <p>A5：公司认为存储行业未来有三个发展趋势：一是在云、边、端三个方面的 AI 深度应用，AI 要求存储具有大容量和高带宽的特点，边缘、端侧更强调存储低延迟、高性能和小尺寸，因此需在芯片设计、先进封装、测试设备等多个技术领域适应 AI 时代，做出满足更大容量、更高性能、更低功耗、更小尺寸综合要求的产品，通过差异化的解决方案提升方案价值；得益于公司研发封测一体化布局，公司在主控芯片设计、解决方案研发和先进封测等领域的技术能力行业领先，可为 AI 端侧产品提供低功耗、高性能、小尺寸、大容量的存储解决方案。二是全球贸易摩擦使市场割裂，更加强调本地化交付能力，公司在美洲、印度与欧洲等中国以外重点市场建立本地化服务、生产交付与市场营销团队，能够为公司带来新的商业机会。三是存储与先进封装深度整合，先进封装成为技术前进的主要方向。公司具备提供“存储+晶圆级先进封测”一站式综合解决方案的能力，顺应存储与计算整合的技术发展趋势，公司提供的综合解决方案的价值量相比单独的先进封测服务，具有显著的放大效应，可以在 AI 时代持续创造价值。</p> <p>Q6. 公司先行布局和储备了哪些核心技术来把握 AI 端侧市场的机遇？</p> <p>A6：AI 端侧场景要求存储产品具有高性能、低功耗的特性，过去的存储产品主要通过固件来优化性能，未来要通过主控芯片设计、固件算法与先进封装能力实现差异化竞争。在主控芯片设计方面，公司积极布局芯片研发与设计领域，将采用业界领先的架构设计，提升公司在 AI 手机、AI 穿戴、AI 智驾等领域的高端存储解决方案的产品竞争力；在固件算法方面，公司全面掌握了存储固件核心技术，有能力匹配各类客户典型应用场景，为客户提供创新、优质的存储解决方案；在先进封装方面，公司已掌握 16 层叠 Die、30~40 μm 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平，并构建 Bumping、RDL、Fan-out 等晶圆级先进封装能力。通过主控芯片设计、固件算法与先进封装的协</p>
--	--

	<p>同效应，公司的存储解决方案实现行业领先的产品创新能力和可靠性，能够持续为终端客户提供适合 AI 端侧场景的高性能、低功耗的存储器产品。</p> <p>Q7. 公司在服务器企业级存储领域有什么产品布局？</p> <p>A7：在企业级领域，公司已推出 SATA SSD、PCIe SSD、CXL DRAM 模组、RDIMM、LPCAMM2 及 SOCAMM 等产品线，主要部署于数据中心及服务器，为密集型数据处理及 AI 驱动的工作负载提供高容量、低延迟的存储支持。公司产品目前正处于高速发展阶段，已获得服务器厂商、头部互联网厂商以及国内头部 OEM 厂商的核心供应商资质，并实现预量产出货，标志着公司企业级商业化落地能力的显著提升。同时，公司将持续坚持“5+2+X”的发展战略，在手机、PC、服务器等三大主要细分市场着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 1 月 13 日-1 月 14 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。